1. Produkt | *Product*

MICROCON SMD PURE

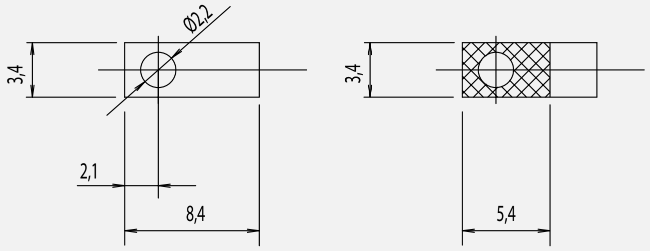
2. Leiterplatten Lötbild | *PCB layout*

Footprint

Footprint

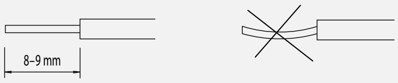
Empfohlene Lötpasten-Auftragsfläche / Lötpasten-Auftragsstärke: max. 0,12 mm

Recommended application area for soldering paste / stencil thickness: max 0.12 mm

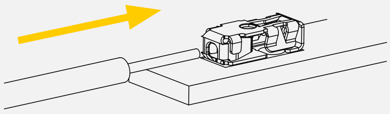


3. Leiter einführen (horizontal) | *Wire insertion (horizontal)*

Eindrähtige Leiter 0,2 – 0,5 mm² | *Solid wires 0.2 – 0.5 mm²*



Abisolierlänge
Wire stripping length

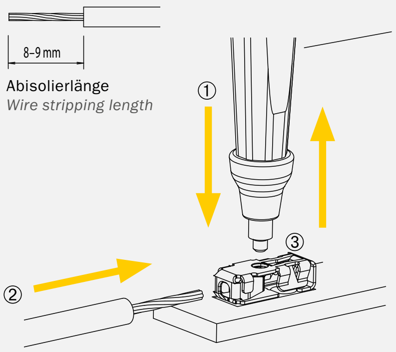


Leiter bis zum Anschlag einführen

Insert wire to the back end

Flexible Leiter 0,5 mm² | *Flexible wires 0.5 mm²*

Abisolierlänge
Wire stripping length



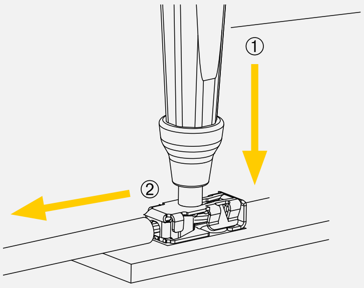
MICROCON SMD PURE
LÖSESTIFT

① Drücken
Push

② Leiter bis zum Anschlag einführen
Insert wire to the back end

③ Lösen
Release

4. Leiter lösen (horizontal) | *Wire release (horizontal)*



MICROCON SMD PURE
LÖSESTIFT

① Drücken
Push

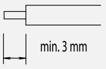
② Leiter herausziehen
Pull out the wire

Alternative für eindrähtige Leiter: Drehen und Ziehen

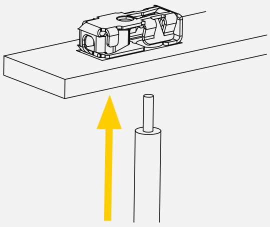
Alternative for solid wires: Twist and pull the wire

5. Leiter einführen (vertikal)
Wire insertion (vertical)

Eindrähtige Leiter 0,5 mm² | *Solid wires 0.5 mm²*



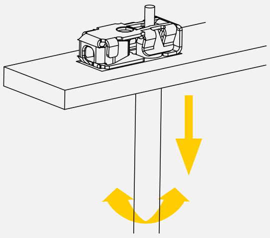
Abisolierlänge
Wire stripping length



Leiter bis zum Anschlag einführen

Insert wire to the back end

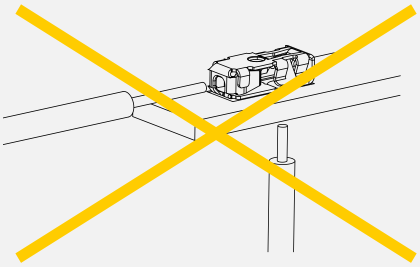
6. Leiter lösen (vertikal)
Wire release (vertical)



Leiter drehen und Ziehen

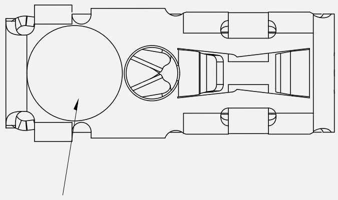
Twist and pull the wire

7. Bitte beachten
Please note



Entweder horizontalen **oder** vertikalen Anschluss verwenden.
*Use either horizontal **or** vertical terminal.*

8. Bestückungs- und Lötinformation
Pick & place and soldering information



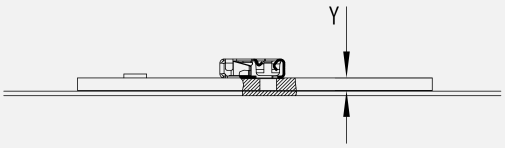
Ansaugfläche Ø 2,5 mm

Pick & place area Ø 2.5 mm

Maximale
Löttemperatur / -zeit:
265 °C / 95 sec.

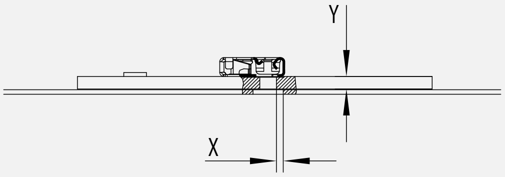
Max. peak soldering
temperature / time:
265 °C / 95 sec.

9. Kriech- und Luftstrecken beim Verbau von Leiterplatten mit Loch für das vertikale Stecken beachten
Mind creepage and clearance distances for the mounting of PCBs with hole for vertical connection



Ausreichende Kriech- und Luftstrecke Y zur
Leiterplattenbefestigungsfläche beachten.

Please consider sufficient creepage and clearance
distance Y between life part and mounting surface.



Ausreichende Kriech- und Luftstrecke X + Y zur
Leiterplattenbefestigungsfläche beachten.

Please consider sufficient creepage and clearance
distance X + Y between life part and mounting surface.